

不織布パッド

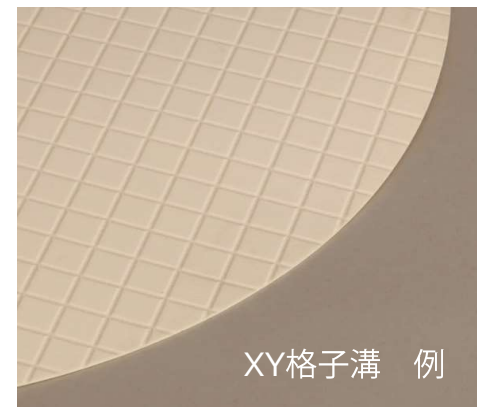
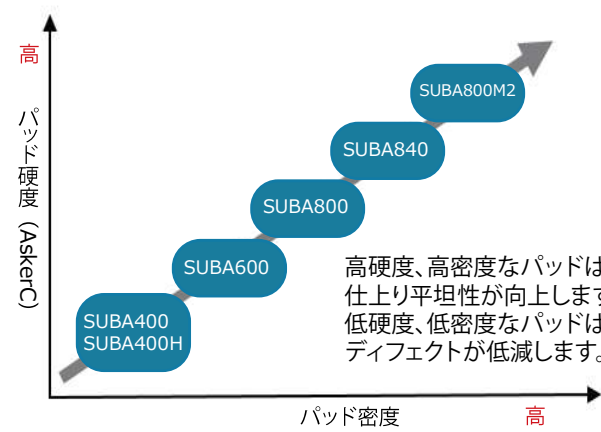
SUBA™

用途

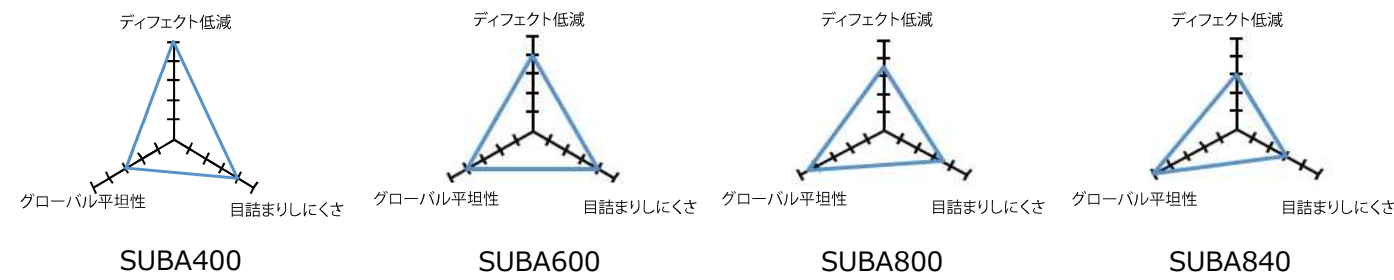
シリコンウェーハ、石英、水晶、金属
サファイアやLT・LN・AlN・GaN・SiC
など基板の研磨

幅広い用途に使いやすい不織布パッド

シリコンウェーハに代表されるあらゆる基板のポリッシングに幅広く使えるベストセラー。
お客様の製品の量産に欠かせないパッド寿命や品質安定性も定評があります。



特長



ラインナップ

	特長	硬度/密度
SUBA400	・スクラッチ抑制に優れ、高い追従性。目詰まりしにくい	低硬度・高圧縮率 ソフトType
SUBA400H	・SUBA400と比べ高硬度、高平坦性	
SUBA600	・中圧研磨で最も優れたウェーハ平面性 ・スクラッチ抑制と平坦性のバランスに優れた万能タイプ	
SUBA800	・SUBA600と比べ高硬度・高密度、高平坦性	
SUBA800K3	・親水性を付与し、サファイアA面研磨において高研磨レートを発揮	
SUBA808	・パッド厚さが0.7mmで、薄物の研磨に最適	高硬度・低圧縮率 ハードType
SUBA840	・SUBA800と比べ高密度、高平坦性	
SUBA800M2	・SUBA840以上の高平坦性を実現	
SUBA800M4	・特殊繊維の採用により、高密度かつパッドグレージングの抑制を両立	
SUBA800T2	・SUBA800M2以上の高硬化化により、高平坦性・高研磨レートを達成	

※SUBA800K3は開発品です。

物性値

	SUBA400	SUBA400H	SUBA600	SUBA800	SUBA840	SUBA800M2	SUBA800M4	SUBA800T2
厚み(mm)	1.27	1.28	1.27	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
硬度 (Asker C)	60	67	80	83	84	87	87	90
圧縮率 (%)	9.4	9.4	4.2	3.3	2.6	2.7	2.3	2.0

※圧縮率: W1=300gf/cm², W2=1800gf/cm²にて測定

※その他、本カタログ掲載以外の各種パッドを数多く取り揃えていますので、お気軽にご相談ください。

パッドサイズを選択について

φ8～φ62インチまでの円形で、貴社研磨機の定盤径+10mm程度を目安に直径をご指定下さい。
定盤貼付け用の粘着テープ付きで製作致します。また、正方形や長方形、ドーナツ加工での製作も可能です。

パッド用工具

ポリッシングパッドの性能を最大限引き出すツールもご用意しています。

パッドのブレイクイン・クリーニングに
コンディショニングブラシ



エア噛み予防や貼付け精度向上に
パッド貼付け工具



パッド交換時の労力軽減に
研磨パッド剥がし治具



ポリッシングパッド